

【原因、判断要点、发生工序】SR 基底附着杂物或者 SR 内部混入杂物，致使 SR 像弹坑那样迸开变薄（涂布 SR 工序）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】

Solder resist ink is left on a surface and then recedes to form a crater-like shape caused by foreign objects on the base material or in the solder resist as a nucleus. (Solder resist application process)

2-2-1-15 SR 表面粘着物付着／SR 表面附着粘性物／Adhesive material on solder resist surface

【特徴】SR 表面に、糊や粘着物が付着している状態の欠陥

【特征】SR 表面附着胶或者粘性物的缺陷。

【Characteristics】Adhesive or sticky material is attached to the solder resist surface.

【原因・判断ポイント・発生工程】SR 塗布乾燥後に誤って糊や粘着物を接触させて出来たもの（SR 塗布乾燥後工程）

【原因、判断要点、发生工序】错误地让 SR 涂布烘干后的板面接触胶或者粘性物所引起的（SR 烘干后工序）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】

Caused by a careless contact of adhesive or sticky material after solder resist application (After solder resist application)



【コメント】顕微鏡倍率×55

【注釋】显微镜倍率×55

【Comments】Magnification: ×55



【コメント】顕微鏡倍率×55

【注釋】显微镜倍率×55

【Comments】Magnification: ×55

2-2-2 異物非残存（SR 欠陥）／非杂物残留（SR 的缺陷）／ Marks of foreign object(solder resist defects)

2-2-2-1 鉄基板異物剥離部 SR 不付き／铁基板的杂物剥离部位的 SR 剥落／

Solder resist missing on iron-base printed board due to a peeled foreign object/resist

【特徴】鉄板面の SR が異物形状どおりについていない状態の欠陥、SR 不付き部が錆びているケースが多い

【特征】铁基板面の SR 像杂物形状那样剥落的缺陷，多数的情况是 SR 剥落部位氧化。



【コメント】顕微鏡倍率×

【注釋】显微镜倍率×

【Comments】Magnification: ×